

Dodd-Frank Act – Positionsdarstellung

Poole, 28.06.2016

Der US-amerikanische **Dodd-Frank Act** zur Reform des US Finanzmarktrechtes wurde im Juli 2010 von Präsident Obama unterschrieben.

Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Acts geht auf **Konfliktrohstoffe**, aus der Demokratischen Republik Kongo (sowie Nachbarländer) ein, und benennt explizit Coltan, Wolfram, **Gold** und **Zinn**, wovon die beiden letzteren in der **Leiterplattenherstellung** eine Rolle spielen. Der Begriff „Konfliktrohstoffe“ beruht auf der Finanzierung bewaffneter Konflikte mittels der Erlöse aus Rohstoffverkäufen in diesen Ländern.

An der US-Börse gelistete Unternehmen werden durch Dodd-Frank verpflichtet, offen zu legen, **ob in ihren Produkten Konfliktrohstoffe eingesetzt werden**, welche aus der DR Kongo oder Nachbarländern stammen.

Die **EICC** (Electronic Industry Citizenship Coalition) sowie die **GeSI** (Global e-Sustainability Initiative) nehmen die Unternehmen in die Pflicht, mit **zumutbarer Sorgfalt bei der Auswahl ihrer Lieferkette** zu gewährleisten, dass die **genannten Metalle nicht aus Minen in der Konfliktregion** bezogen werden, welche durch militärische Außer-Regierungs-Gruppen oder rechtswidrige militärische Fraktionen kontrolliert werden.

Der **ZVEI** (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e. V.) stellt zudem fest, dass das Thema der Konfliktmineralien tief in die Lieferketten deutscher und europäischer Unternehmen eingreift und es somit gilt **für die EU** ein Gesetz à la Dodd-Frank zu verhindern und vielmehr **eine humanitär sinnvolle und für die Industrie tragbare Lösung** zu erreichen, wie z.B. die **Zertifizierung der Schmelzbetriebe** als "Flaschenhals", da diese Art der Zertifizierung als einzige **nachvollziehbar und überprüfbar** ist. Nur vor der Schmelze ist ein chemischer/geologischer Herkunftsnachweis (Fingerprint) möglich.

Multi Circuit Boards unterstützt sowohl die Aktionen des ZVEI, als auch der EICC und GeSI.

Wir haben die **Informationen unserer Lieferanten** bzgl. der Herkunft der verwendeten, betroffenen Metalle welche im Produktionsprozess verwendet werden entweder schon erhalten oder sind gerade dabei diese zu erfragen.

Basierend auf den Informationen, welche uns von unseren Lieferanten zur Verfügung gestellt wurden, sind in den **von Multi-CB gelieferten Produkten** nach unserem aktuellen Kenntnisstand **keine Metalle aus der Konfliktregion enthalten**.



**Printed Circuit Boards
Leiterplatten**

Low price, high tech – see online calculator for prototypes, small and large volume 1-48 layers
Internet: www.multi-circuit-boards.eu - Email: info@multi-circuit-boards.eu



Kundenbetreuung / Support: Multi Leiterplatten GmbH, Brunthaler Str. 2, DE-85649 Brunthal, Tel. +49 (0) 8104 6280

Lieferanten von Metallen welche bei der Herstellung von Multi-CB Produkten verwendet werden (insbesondere Gold und Zinn), müssen nachweisen, dass sie die grundsätzlichen Anstrengungen der **EICC und GeSI verstehen und unterstützen** und nicht wissentlich Konfliktrohstoffe beziehen.

Zudem **unterstützen wir die Anstrengungen des ZVEI** um für Zulieferer Europäischer Unternehmen eine verpflichtende Registrierung der Schmelzbetriebe durchzusetzen, anstatt der komplizierten und wirkungslosen Offenlegung der kompletten Lieferkette.

Multi Circuit Boards Ltd.

Trading Address:
Multi Circuit Boards Ltd.
Business Centres, Holyrood Close
GB-Poole, BH17 7FJ
VAT-ID: DE281397430

Registered Address:
Multi Circuit Boards Ltd.
9 Pullman Business Park, Pullman
Way, GB-Ringwood, BH24 1HD
GB Co.Reg: 07909372

Contact:
Tel: +44 1425 489 111
Fax: +44 1425 471 715
info@multi-circuit-boards.eu
www.multi-circuit-boards.eu

Commerzbank Munich
BLZ / sort code: 70040048
KTO / account no.: 763340700
SWIFT / BIC: COBADEFF970
IBAN: DE31700400480763340700